

WPN 10

Wärmeleitpaste

austerlitz
electronic gmbh

Anwendungsbeispiele

- Optimiert Wärmeleitung zwischen elektronischen Bauelementen und Kühlkörpern mit mittlerer bis höherer Leistungsdichte wie z. B. Halbleiter (Transistoren, Dioden, Thyristoren usw.) sowie andere integrierte Bauteile

Eigenschaften

- Oxidations- und alterungsbeständig
- Nicht toxisch
- Vermeidet Lufteinschlüsse
- Geruchsneutral
- Chemisch indifferent gegenüber Kunststoffen und Metallen

Typische Kenndaten

- Einsatztemperatur: -40 °C bis +150 °C
- Aussehen: weiß
- NLGI-Klasse: 2 – 3*

Dickungsmittel	Bentonit		
Ruhpenetration	1/10 mm	250 - 290	DIN ISO 2137
Wärmeleitfähigkeit bei 25 °C	W/mK	ca. 0,8	Methode PTB**
Ölabscheidung (40 °C/168 h)	%	≤ 2	DIN 51817
Fließdruck bei +20 °C	mbar	≤ 500	DIN 51805
Grundöl	Silikonöl		
Kin. Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	ca. 75	DIN 51562
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	ca. 32	DIN 51562

Gebrauchshinweise

- Produkt sollte innerhalb von 6 Monaten ab Produktionsdatum weiterverarbeitet bzw. aufgebraucht sein
- Vor Serieneinsatz wird eine Produktverträglichkeitsprüfung empfohlen

* Angabe bezieht sich auf Ruhpenetration

** Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (Heizbrückenverfahren)